

第 119 回マイクロ接合研究委員会 プログラム

日 時：平成 29年 9月 29日(金) 10:30～16:25

場 所：大阪大学 医学・工学研究科 東京ブランチ 913 会議室(東京 日本橋)

時 間	題 目	講 演 者
司 会 佐野 智一 (大阪大学)		
10:30～11:25	『表面微細構造を利用した金属・樹脂直接接合』 (資料番号MJ-726-2017)	東京大学 生産技術研究所 ○梶原優介、木村文信 門屋祥太郎
11:25～12:20	『常温接合を用いたウェーハ接合装置』 (資料番号MJ-727-2017)	三菱重工工作機械株式会社 ○後藤崇之
12:20～13:30	昼 食 休 憩	
13:30～13:40	委 員 会 議 事	
司 会 岩本 知広 (茨城大学)		
13:40～14:25	『電子機器を中心とした金属接合部の信頼性評価 ・解析および試験』 (資料番号MJ-728-2017)	OKI エンジニアリング株式会社 ○中村隆治
14:25～15:20	『Ag 焼結接合および応力緩和構造を適用した SiC パワーモジュールの信頼性評価』 (資料番号MJ-729-2017)	株式会社デンソー ○杉浦和彦
15:20～15:30	休 憩	
司 会 武井 利泰 ((株)ジャパン・ユニックス)		
15:30～16:25	『原子分解能 STEM による材料界面解析』 (資料番号MJ-730-2017)	東京大学 工学系研究科 ○柴田直哉

※プログラムは都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。